

第51期定時株主総会



東京エレクトロン株式会社
平成26年6月20日

第51期 業績報告

連結損益計算書

(億円)

	第50期 (%)		第51期 (%)		増減
	金額	比率	金額	比率	
売上高	4,972	100.0	6,121	100.0	+1,148
営業利益	125	2.5	322	5.3	+196
経常利益	166	3.4	354	5.8	+187
特別利益	15		5		▲9
特別損失	▲4		▲477		▲473
税引前利益	177	3.6	▲117	▲1.9	▲295
当期純利益	60	1.2	▲194	▲3.2	▲254

連結損益計算書

(億円)

		第50期 (%)		第51期 (%)		増減
売上高		4,972	100.0	6,121	100.0	+1,148
部門別売上	SPE	3,920	78.8	4,788	78.2	+868
	FPD	200	4.0	283	4.6	+82
	PVE	0	0.0	38	0.6	+37
	EC/CN	846	17.0	1,007	16.5	+160

SPE: 半導体製造装置
PVE: 太陽光パネル製造装置

FPD: フラットパネルディスプレイ
EC/CN: 電子部品/情報通信機器

連結損益計算書

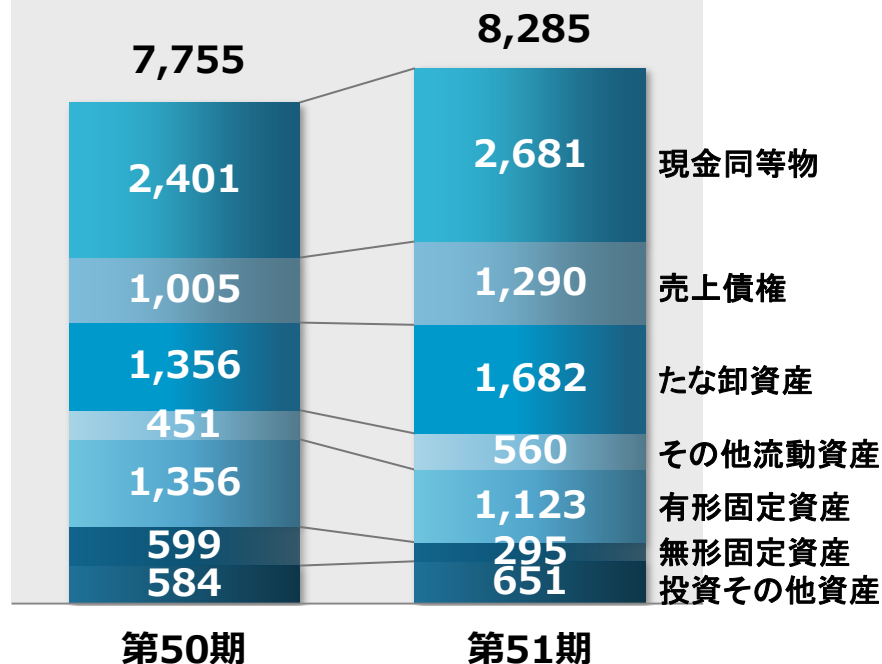
(億円)

	第50期 (%)		第51期 (%)		増減
	金額	比率	金額	比率	
売上高	4,972	100.0	6,121	100.0	+1,148
営業利益	125	2.5	322	5.3	+196
経常利益	166	3.4	354	5.8	+187
特別利益	15		5		▲9
特別損失	▲4		▲477		▲473
税引前利益	177	3.6	▲117	▲1.9	▲295
当期純利益	60	1.2	▲194	▲3.2	▲254

連結貸借対照表

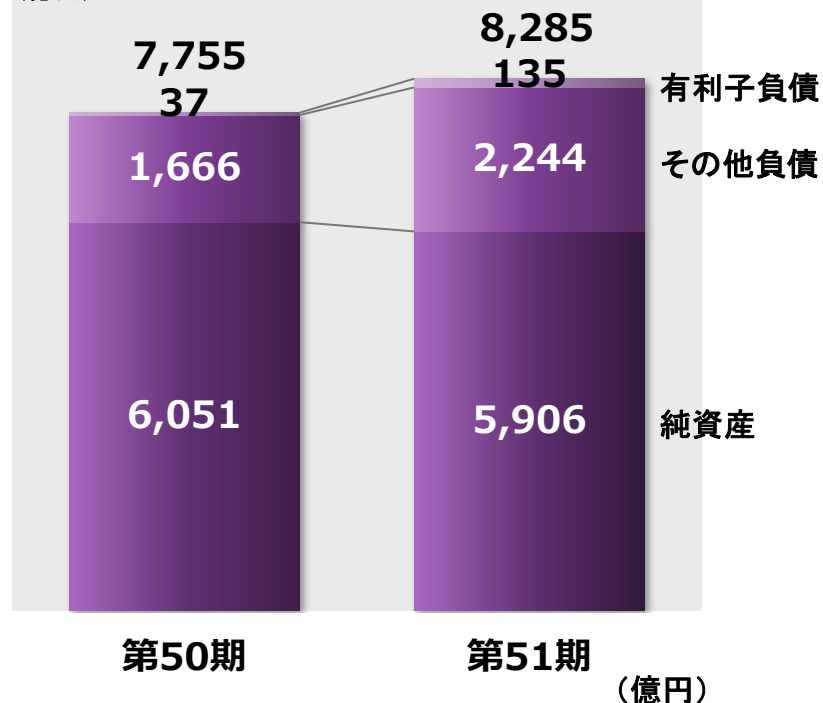
資産

(億円)



負債・純資産

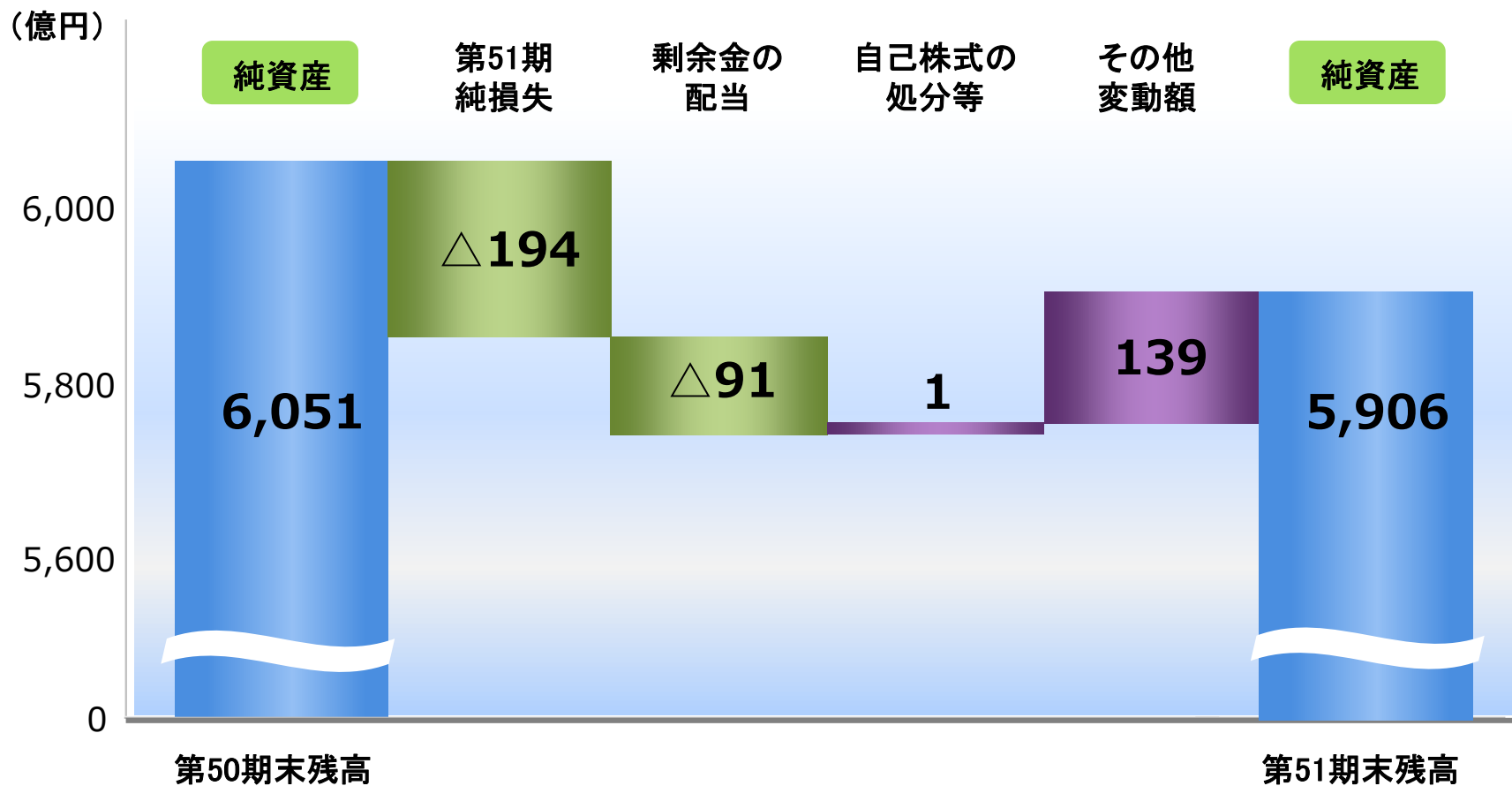
(億円)



主な増減		増減	主な要因
資産	現金同等物	+280	
	売上債権	+285	売上増に伴う増加
	たな卸資産	+325	生産増および出荷済み未設置在庫の増加
	有形固定資産	-233	取得(+127), 減価償却(-217), 減損(-102)
	無形固定資産	-303	減損: PVE(-316), NEXX(-50)
負債	その他負債	+578	前受金の増加(+209), 買掛金の増加(+174), 未払法人税等の増加(+117)

現金同等物: 現預金+短期投資等(貸借対照表上の表示は「有価証券」)

連結株主資本等変動計算書



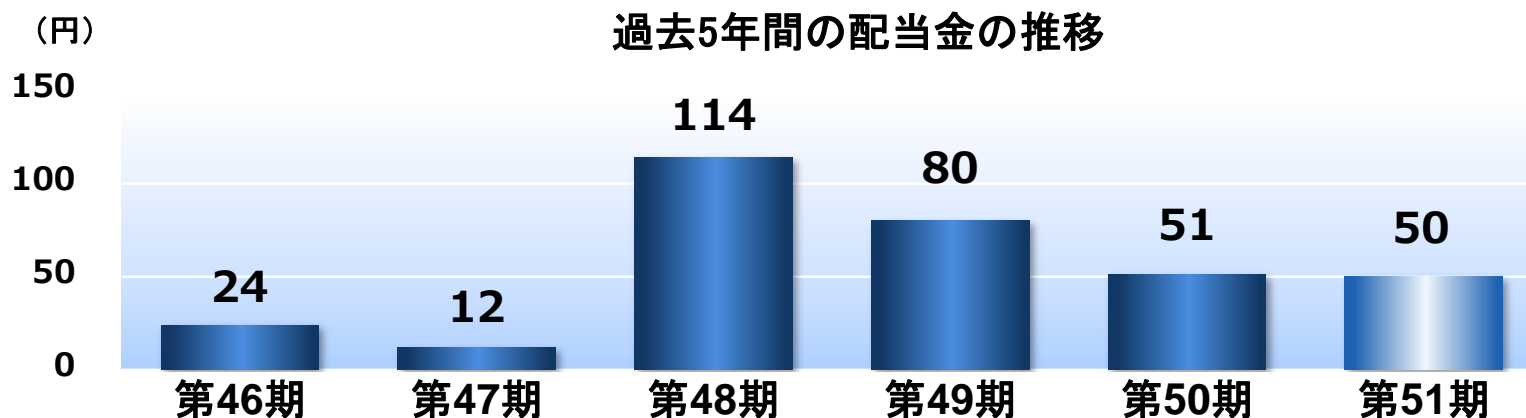
単独財務諸表の概要

損益計算書	第50期 (%)		第51期 (%)		増減	(億円)
	金額	比率	金額	比率		
売上高	3,754	100.0	4,622	100.0	+86	
営業利益	57	1.5	162	3.5	+105	
経常利益	273	7.3	278	6.0	+5	
特別損失	-		552		+551	
税引前利益	282	7.5	▲260	▲5.6	▲543	
当期純利益	229	6.1	▲264	▲5.7	▲494	
貸借対照表						
貸借対照表	第50期 (%)		第51期 (%)		増減	
	金額	比率	金額	比率		
資産合計	5,700	100.0	6,082	100.0	+381	
負債合計	1,797	31.5	2,515	41.4	+717	
純資産合計	3,903	68.5	3,567	58.6	▲336	
負債・純資産合計	5,700	100.0	6,082	100.0	+381	

第51期 配当

▶ 1株当たり配当金

	中間	期末	年間	配当総額	連結 配当性向
第50期	25円	26円	51円	91億円	150.4%
（内 普通配当	15円	16円	31円		
（内 記念配当	10円	10円	20円		
第51期	25円	25円	50円	89億円	—



第52期 業績見通し

事業環境

▶ 半導体設備投資

半導体前工程の設備投資額は、前年比+15%前後を見込んでおり、特にメモリ向け設備投資が拡大すると予測。

▶ フラットパネルディスプレイ(FPD)設備投資

中国における大型パネル向け設備投資を中心に引き続き堅調である。また、有機ELテレビ市場の立ち上がりは2016年以降になると予測。

第52期 連結業績見通し

(億円)

		上期	下期(ご参考)
売上高		2,780	3,070
部門別売上	SPE	2,600	2,850
	FPD	160	160
	PVE	20	60
営業利益		180	480
下段: 営業利益率		6.5%	15.6%
経常利益		180	
当期純利益		110	

● 配当予想
第1四半期配当
10円を予定

SPE: 半導体製造装置 FPD: フラットパネルディスプレイ PVE: 太陽光パネル製造装置

※米国アプライド マテリアルズとの経営統合を2014年の半ばから後半に予定しております。



TM

中長期成長と経営統合

目次

1 事業環境と経営統合の背景

2 統合新会社の概要と将来性

3 目標収益モデル

半導体市場を拓げる3つの波

アプリケーションの拡がり



モバイル機器、医療、ウェアラブル
クラウド・コンピューティング、センサー



半導体搭載量の伸び

車載関連、環境・健康・安全、教育

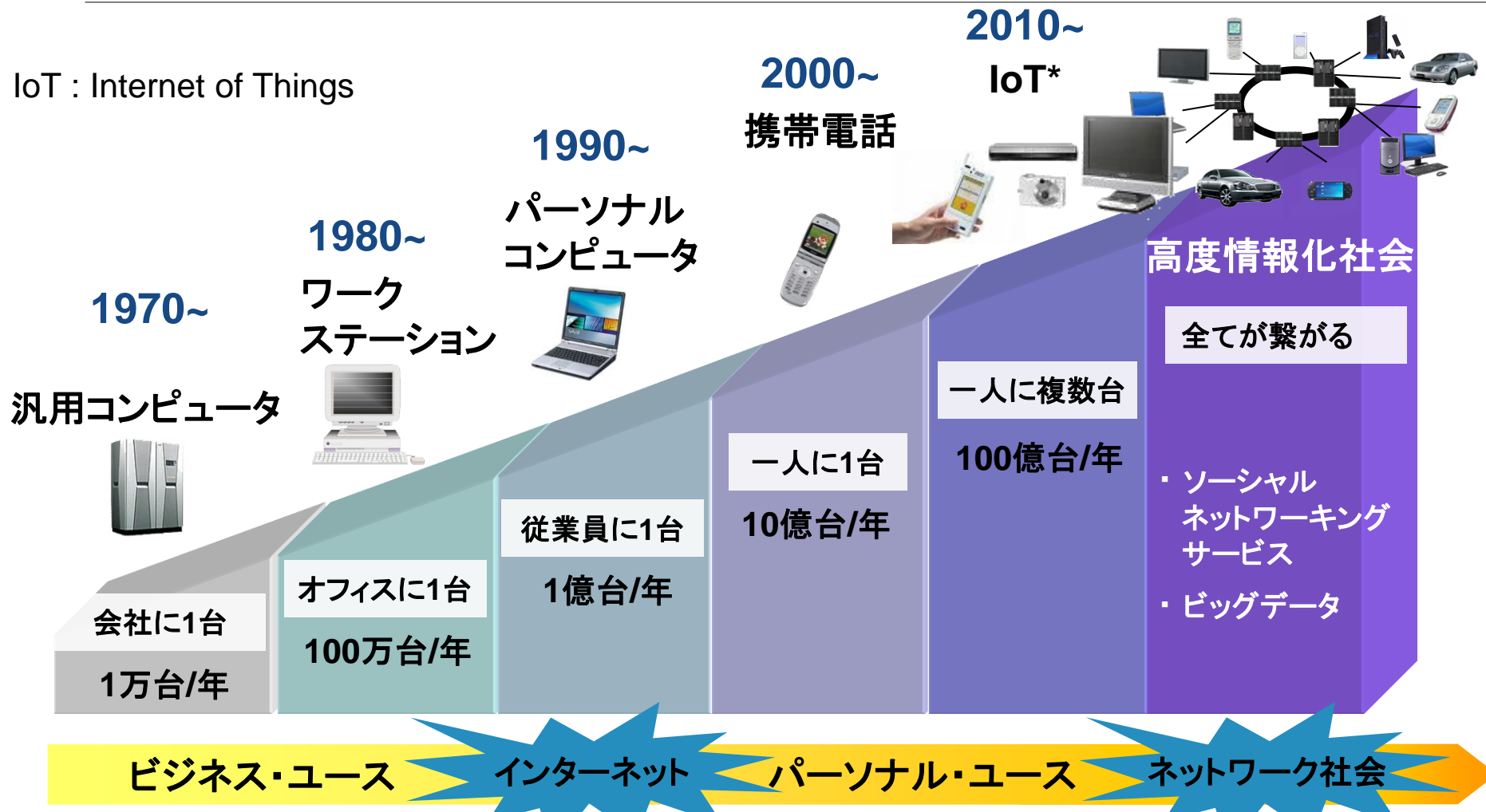
地域的な拡がり

新興国、発展途上国への拡がり



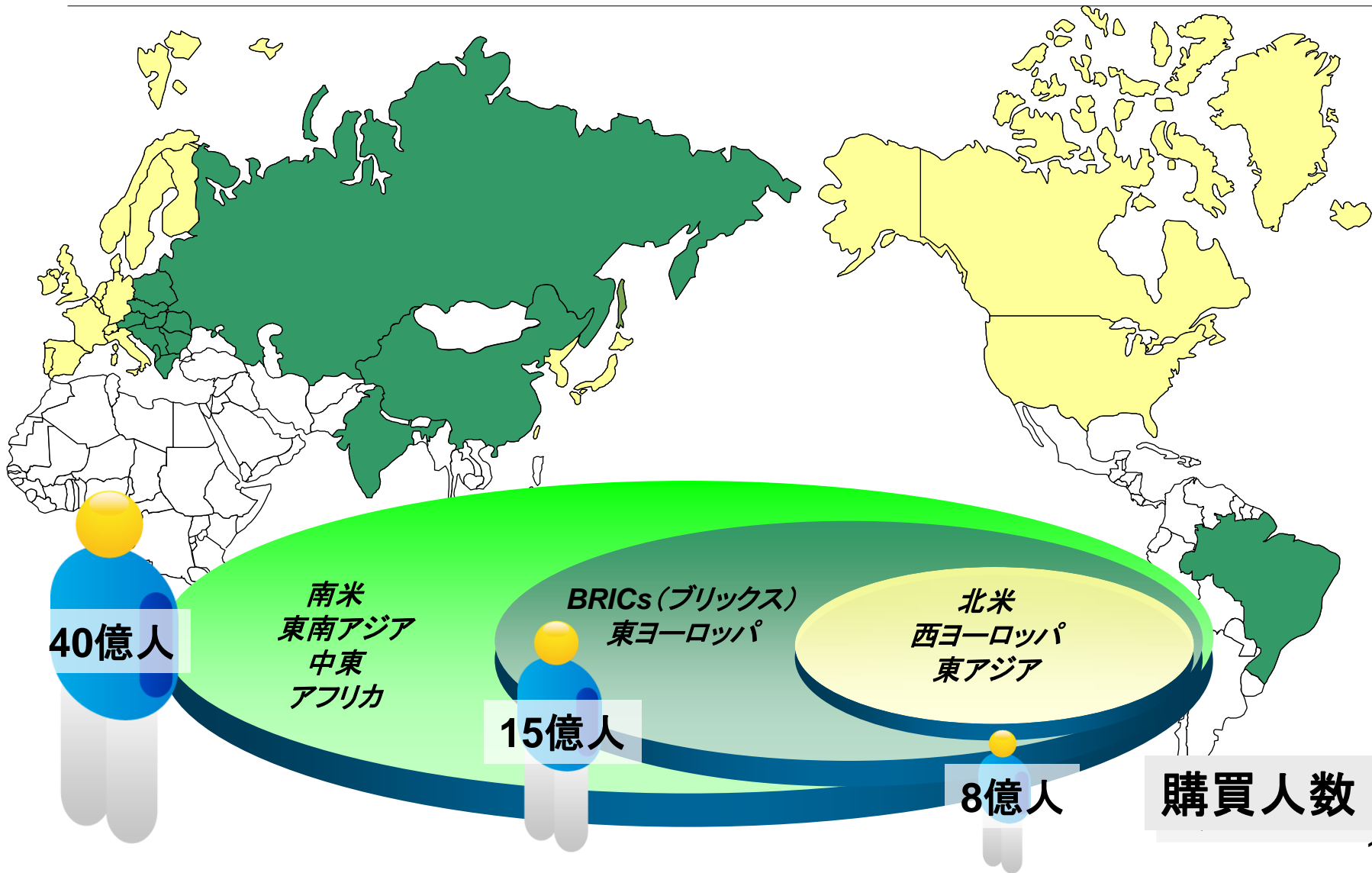
ネットワーク社会の進展

IoT : Internet of Things



いつでも、どこでも、誰でも ⇒ + 全ての物が

電子機器市場の地域的拡がりとお新購買層



高度情報ネットワーク社会を実現する半導体



高度ネットワーク社会の実現に求められる技術革新

ネットワーク社会 モバイル機器 の進化

- ▶ 高機能化
- ▶ 低消費電力化
- ▶ ユーザー
インターフェイス

半導体デバイス 技術の転換点

- ▶ 超高速演算
- ▶ 大容量メモリ
- ▶ 低消費電力化
- ▶ 高解像度画面
- ▶ 低コスト

求められる 技術イノベーション

- ▶ 新材料成膜技術
⇒ 性能向上
- ▶ 超微細加工技術
⇒ 低コスト化
- ▶ 検査・測定技術
⇒ 歩留・品質向上

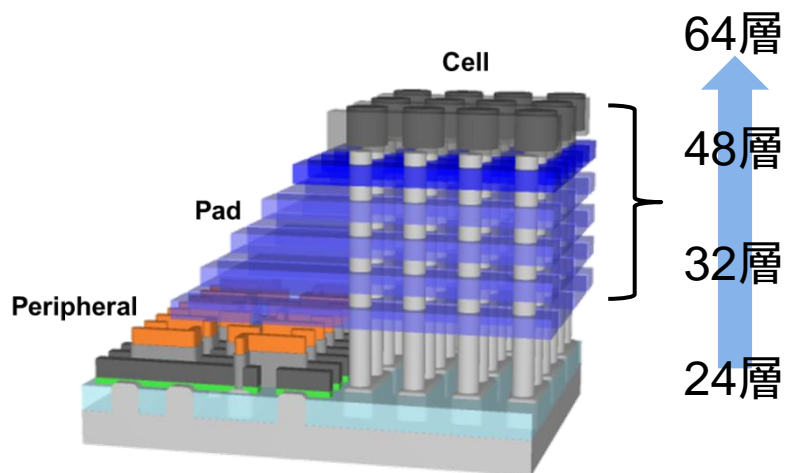


我々に課せられた課題

- 高度な**技術開発力**と強い**財務基盤**
 - ◆ 革新的材料(プレシジョン・マテリアル)工学の技術
 - ◆ 極限の微細加工・検査(パターニング)の技術革新
- 顧客の課題を**スピーディー**に解決するサービス&技術力
- 新興国、発展途上国市場で通用する**コスト・パフォーマンス**

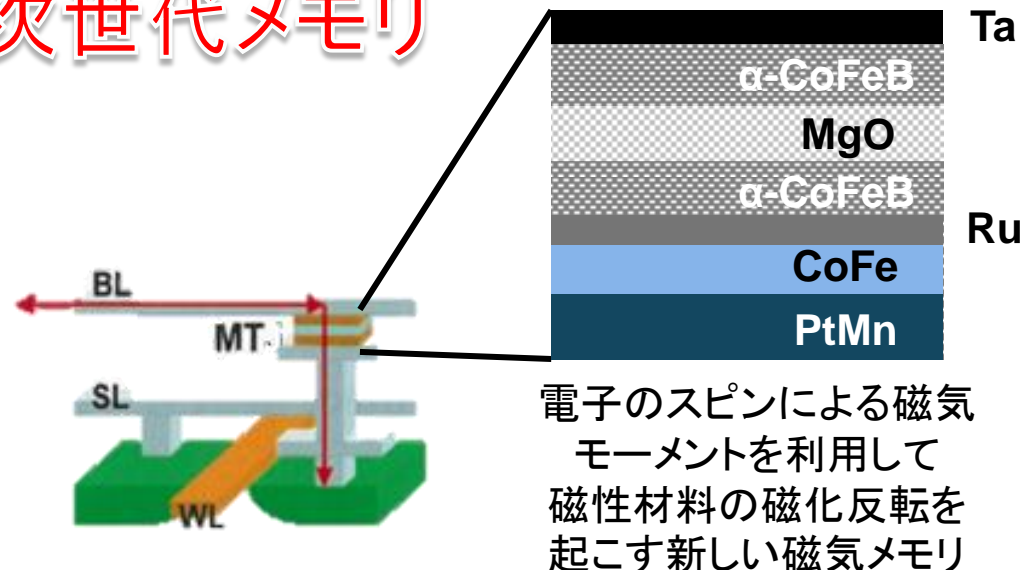
最先端メモリ構造に必須の革新的材料・エッチング技術

3次元メモリ



最新メモリデバイスは
立体的構造

次世代メモリ

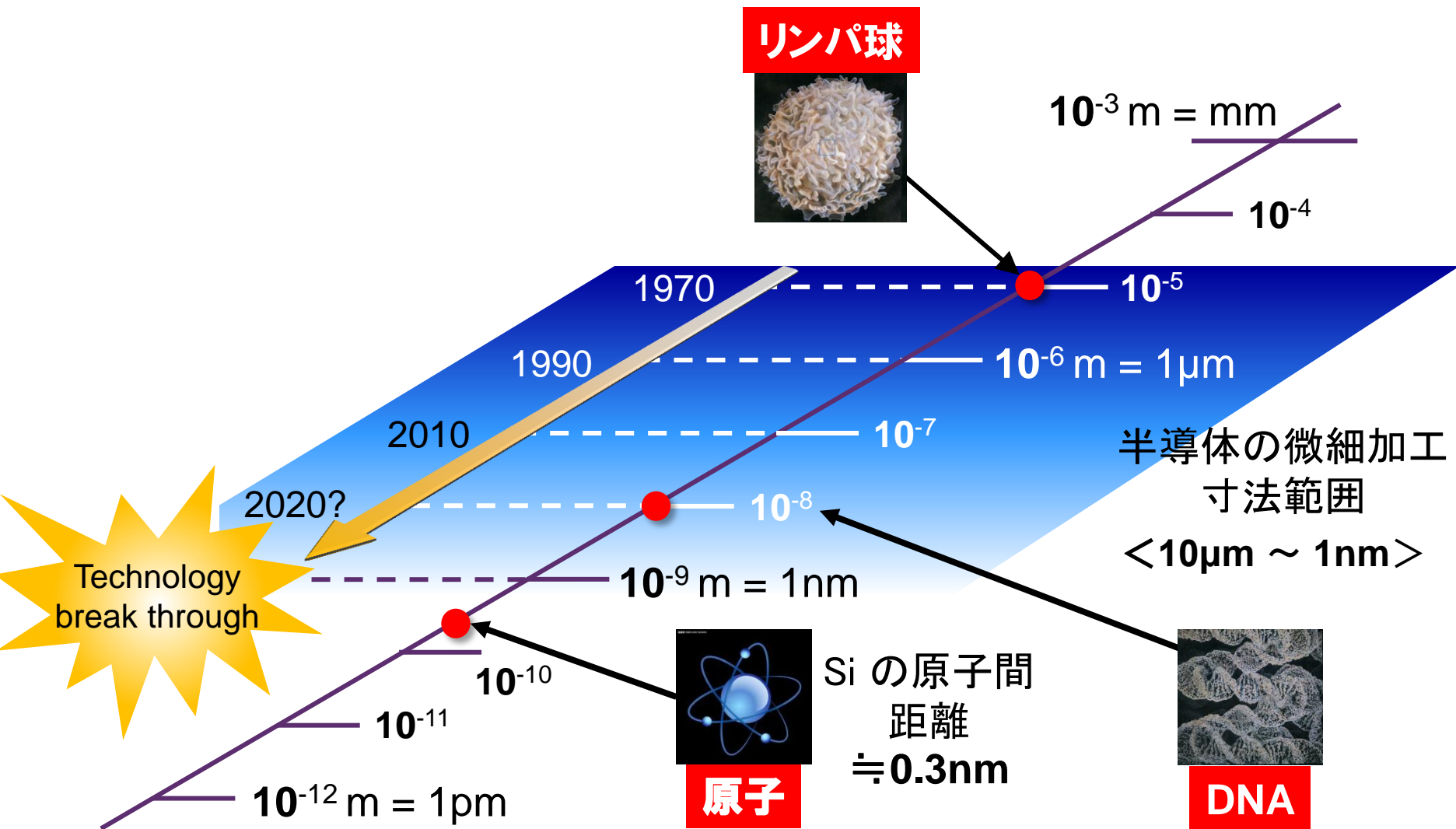


次世代メモリは
革新的材料が必須

革新的材料・エッチング技術 ①
超深穴エッチング技術

革新的材料・エッチング技術 ②
複合多層膜エッチング技術

極限の微細加工・検査(パターニング)の技術革新

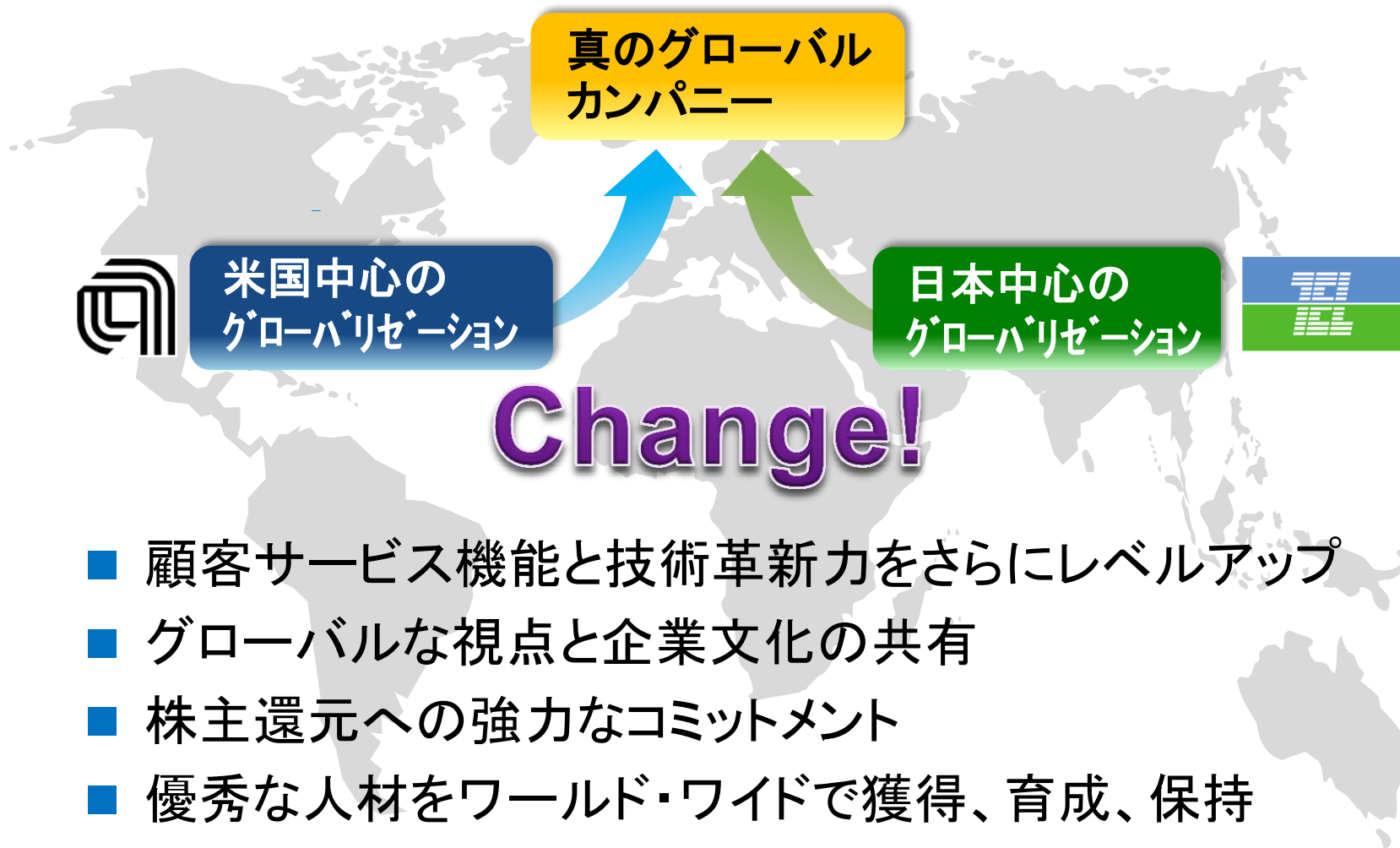


経営統合の発表



September 24, 2013

真のグローバル企業が共有する価値



- 顧客サービス機能と技術革新力をさらにレベルアップ
- グローバルな視点と企業文化の共有
- 株主還元への強力なコミットメント
- 優秀な人材をワールド・ワイドで獲得、育成、保持

目次

1 事業環境と経営統合の背景

2 統合新会社の概要と将来性

3 目標収益モデル

両社の会社概要



TOKYO ELECTRON



設立:	1963年11月	1967年11月
本社:	東京	米国カリフォルニア州 サンタクララ
従業員:	約12,000名	約15,000名
保有特許権:	約16,000 件	約10,500 件
年間売上高 (直近12ヶ月)*	54億ドル	72億ドル
主要技術	塗布現像、拡散・成膜、洗浄、 絶縁膜エッチ、プローブ・テスト、 液晶パネル用エッチ・塗布現像	枚葉成膜、イオン注入、 平坦化、コンダクタエッチ、 欠陥検査、 液晶パネル用成膜
設置済み装置台数	54,000台	33,000台

1. TEL 2013年6月, AMAT 2013年7月
2. TEL の売上高は、1US\$=¥86をベースに算出しています。

(2013年9月24日経営統合発表内容)

新会社の構成

本社所在地
上場市場
法人登記地

東京、サンタクララ(米国カリフォルニア州)
東京証券取引所、NASDAQ株式市場
オランダ

経営陣

会長： 東哲郎
副会長：常石哲男、マイク・スプリンター
CEO： ゲイリー・ディッカーソン

取締役会

取締役11名
両会社各々5名指名(各々3名社外取締役)
両社が推薦する社外取締役1名

統合の条件

統合の構造

- ◆ 両社は、オランダに登記設立される統合新会社の100%子会社となる

交換比率と所有比率

- ◆ TEL株式1株に対し、新会社株式3.25株
- ◆ AMAT株式1株に対し、新会社株式1株
- ◆ TEL株主さまの所有比率は～32.0%

条件と時期

- ◆ 両社の株主総会の承認、各国で適用される競争法に基づく当局による承認が条件
- ◆ 2014年後半予定

経営統合による株主価値向上

両社の最先端技術と製品で、
電子機器、半導体産業界に貢献

収益性の向上

株主還元のさらなる向上を実現

目次

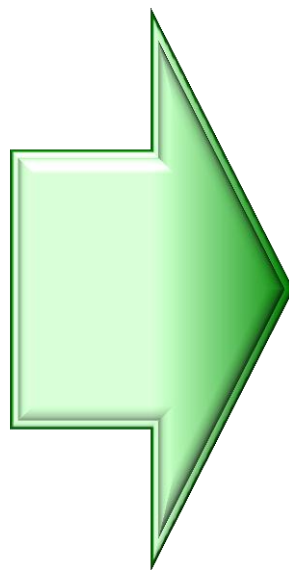
1 事業環境と経営統合の背景

2 統合新会社の概要と将来性

3 目標収益モデル

統合によるシナジー効果(相乗効果)

- サプライチェーンの効率化
- 製造部門の効率化
- ローカル拠点の機能拡大、最適化
- IT投資と会社機能の効率化



シナジー効果額

\$2.5億

初年度

\$5億

初年度からの3年間

(2013年9月24日経営統合発表内容) 32

2017年 目標収益モデル

(2013年9月24日経営統合発表内容)

半導体製造装置市場規模: \$370億を想定

\$182億
売上高

\$46億
営業利益

25%
営業利益率

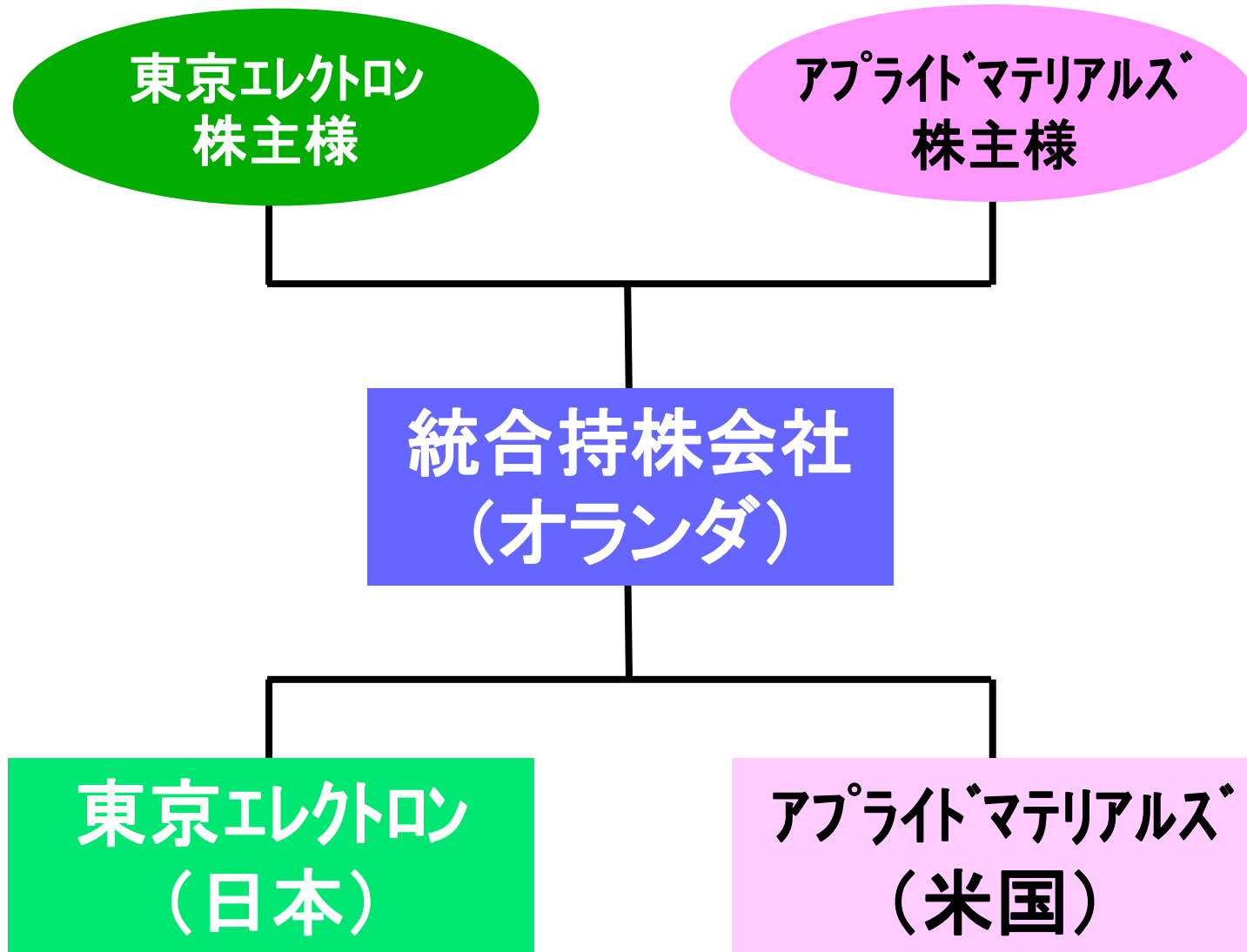
>\$2.40
1株当り純利益

半導体製造装置、ディスプレイ製造装置およびサービス事業の収益モデルになります。(非GAAPベース)

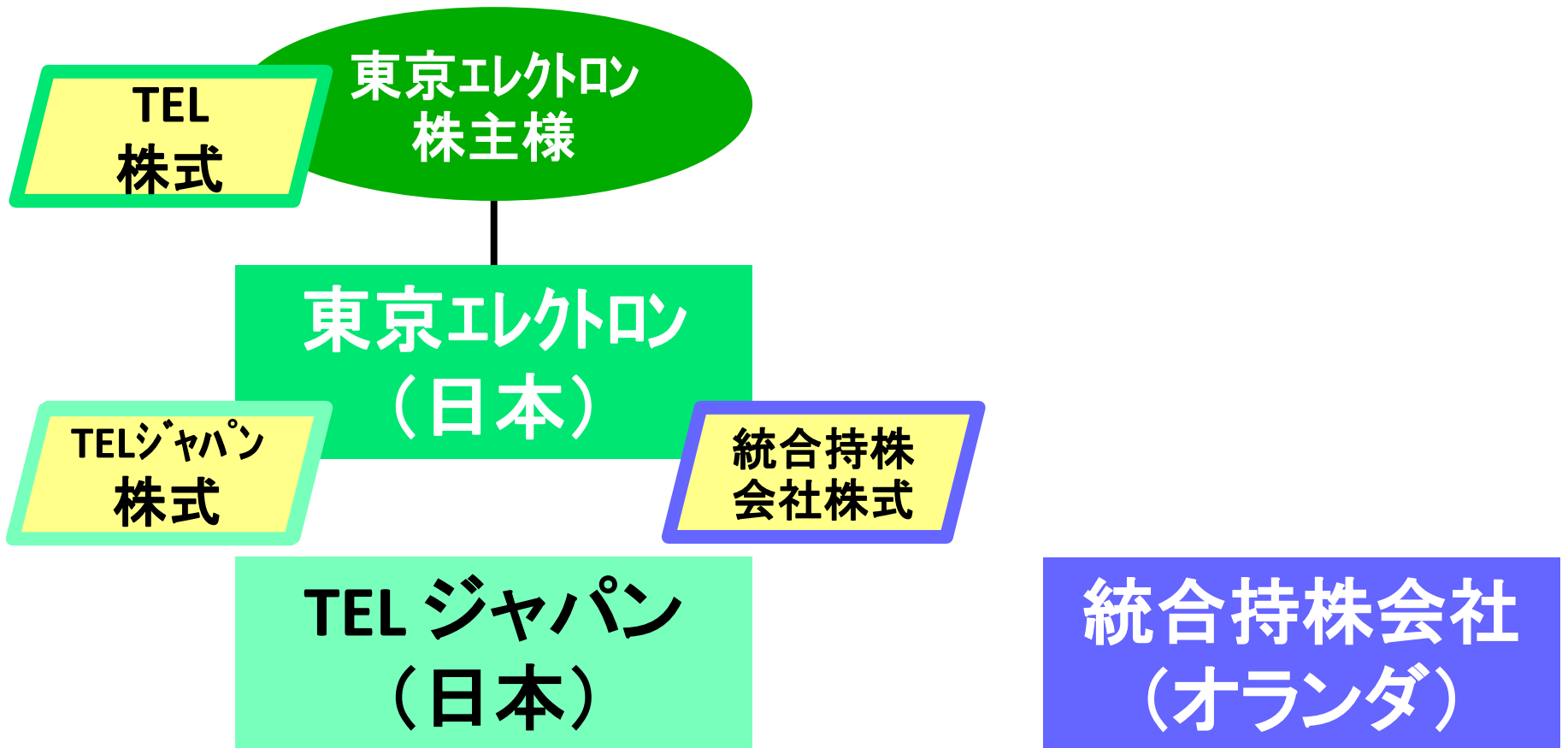
33

経営統合の方法

経営統合の方法

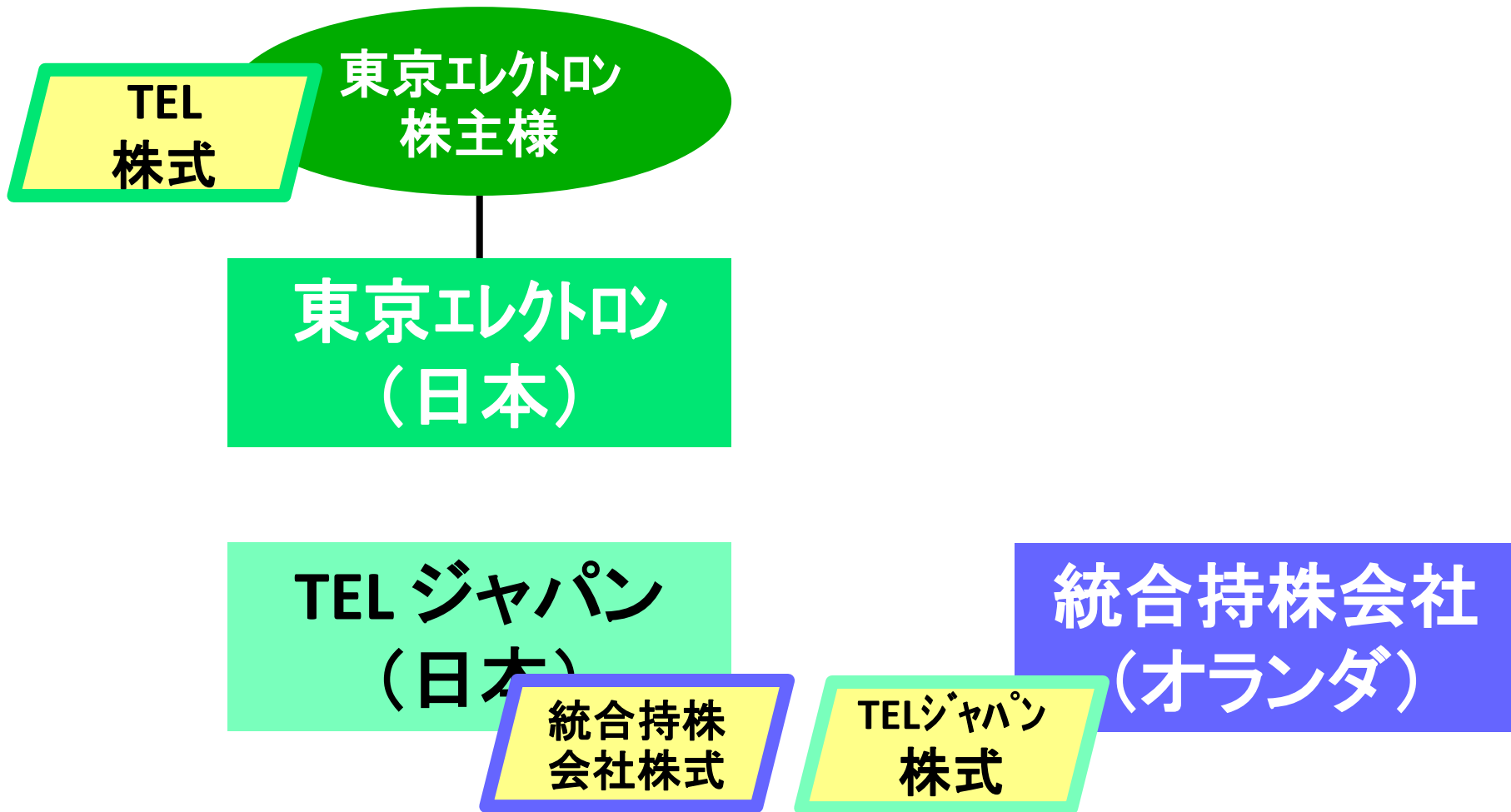


経営統合の方法

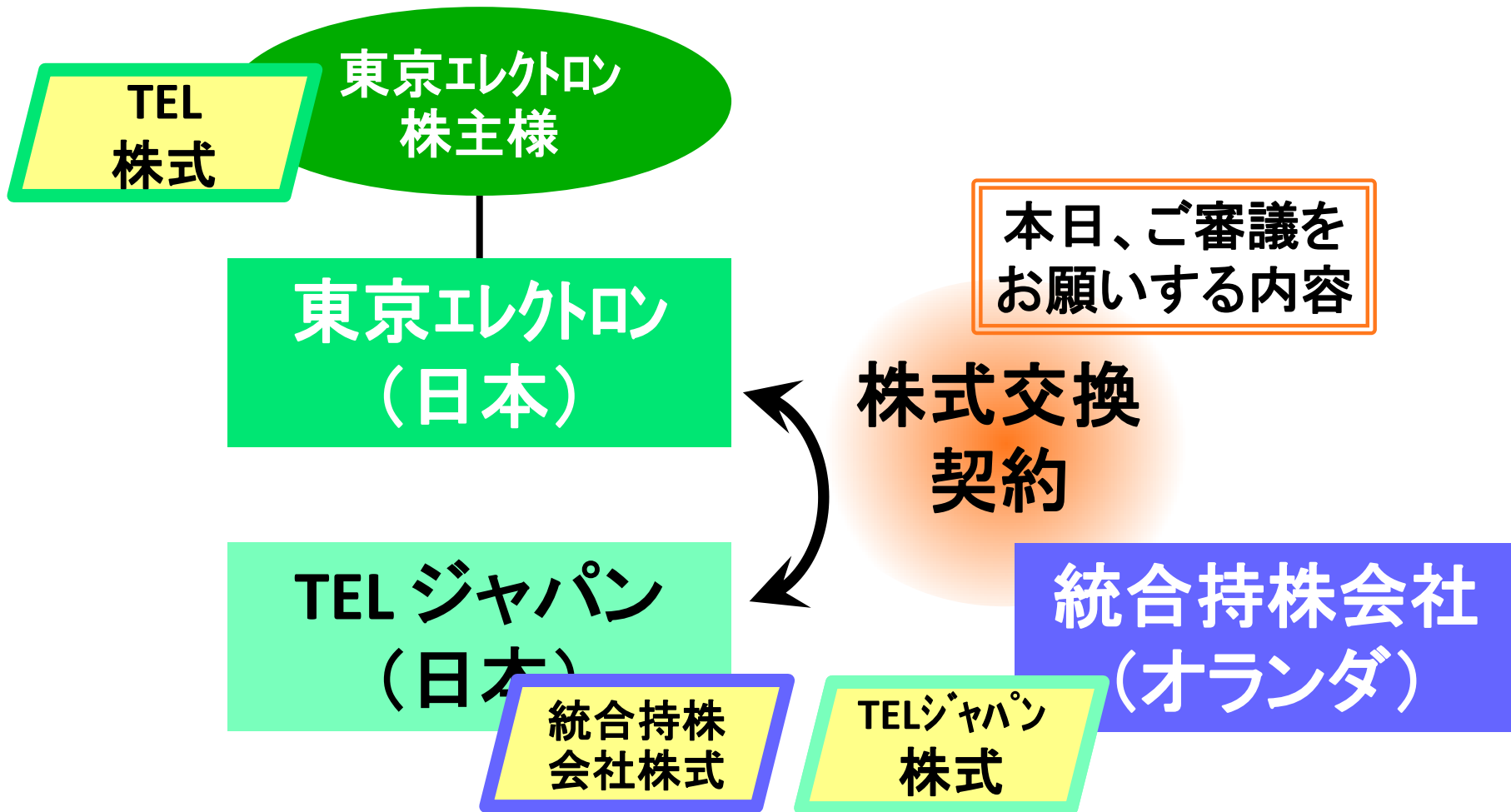


便宜上「TELジャパン株式」と表記しましたが、実際にはTELジャパンは合同会社であるため「持分」となります

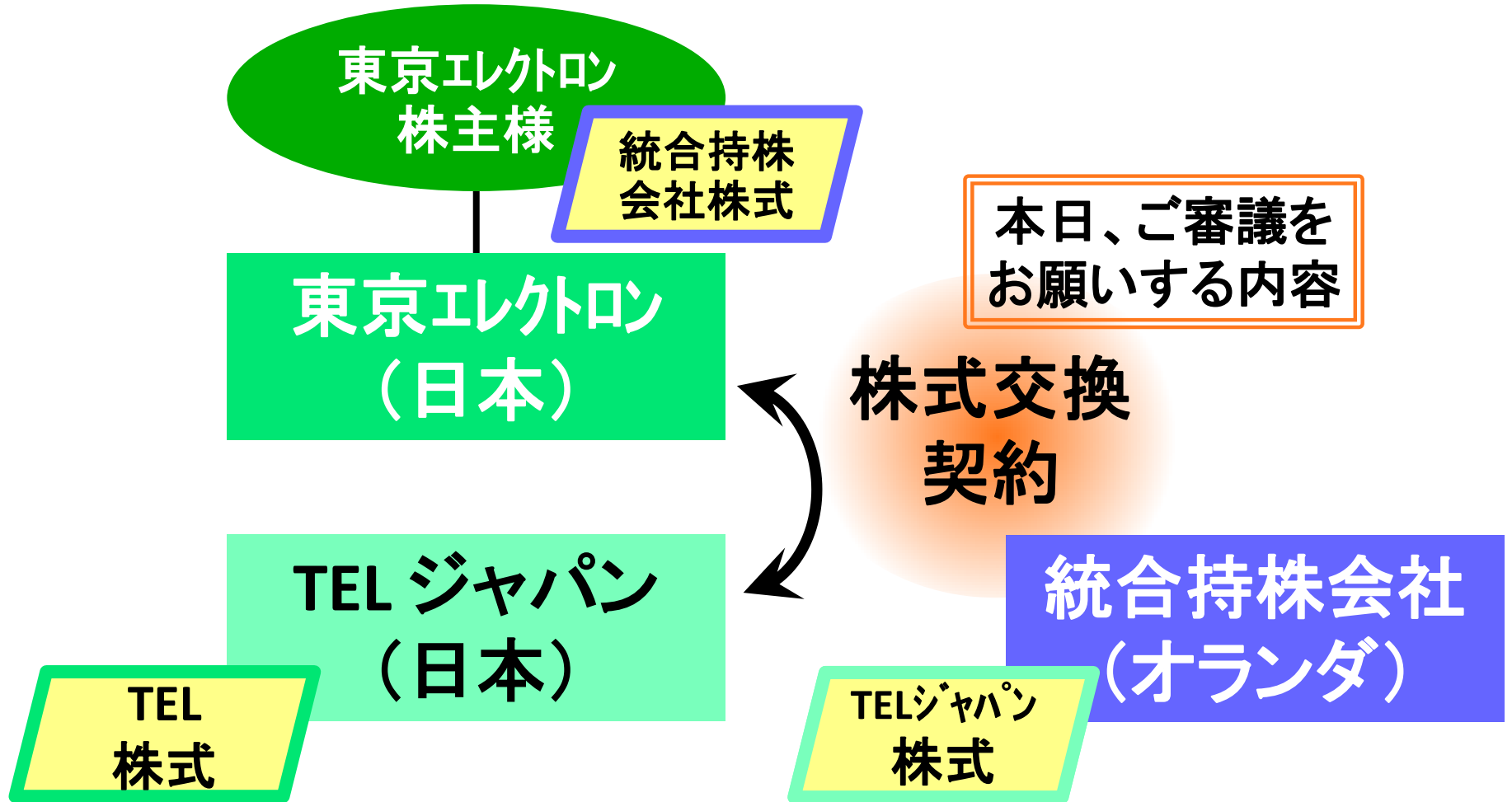
経営統合の方法



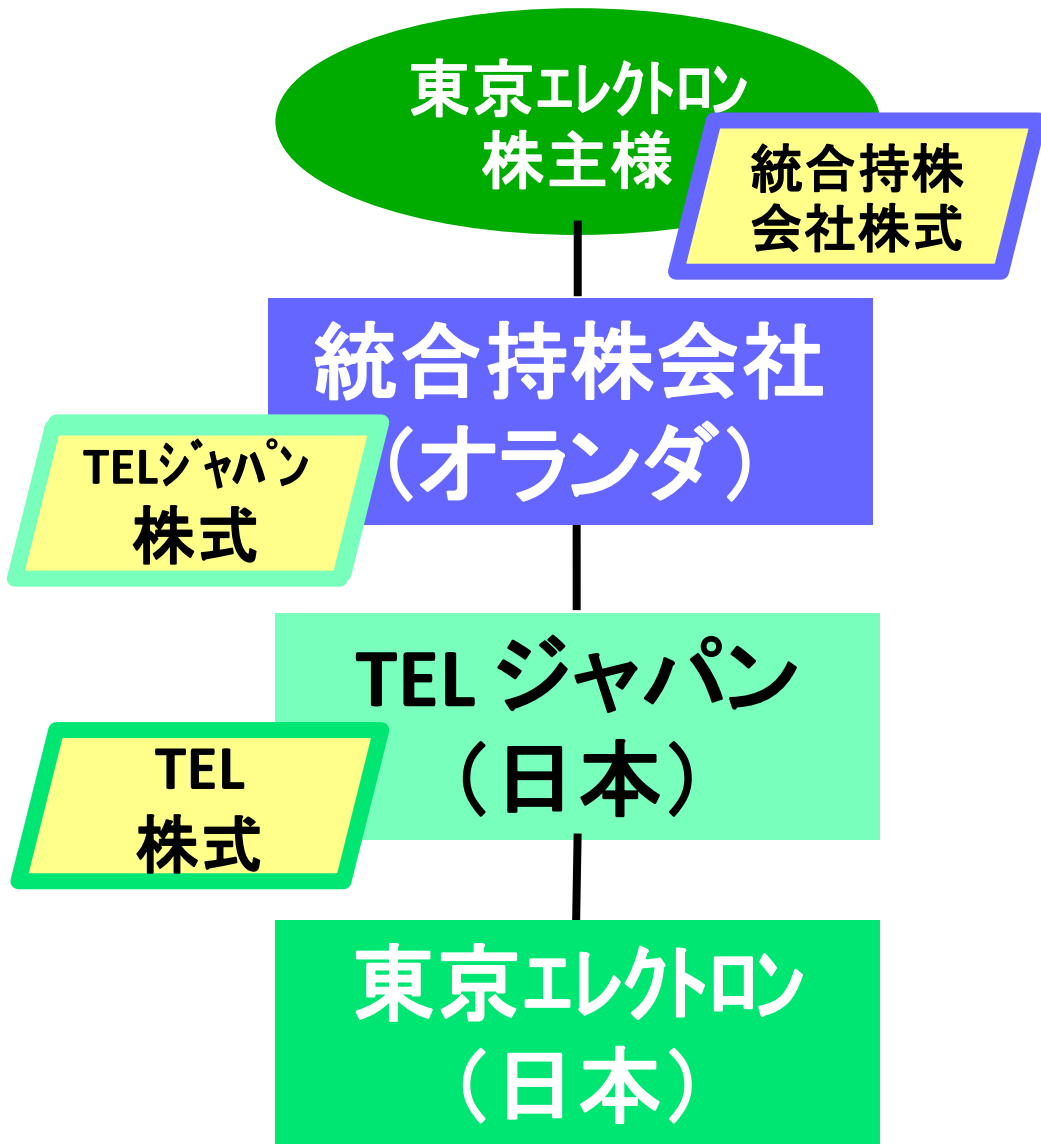
経営統合の方法



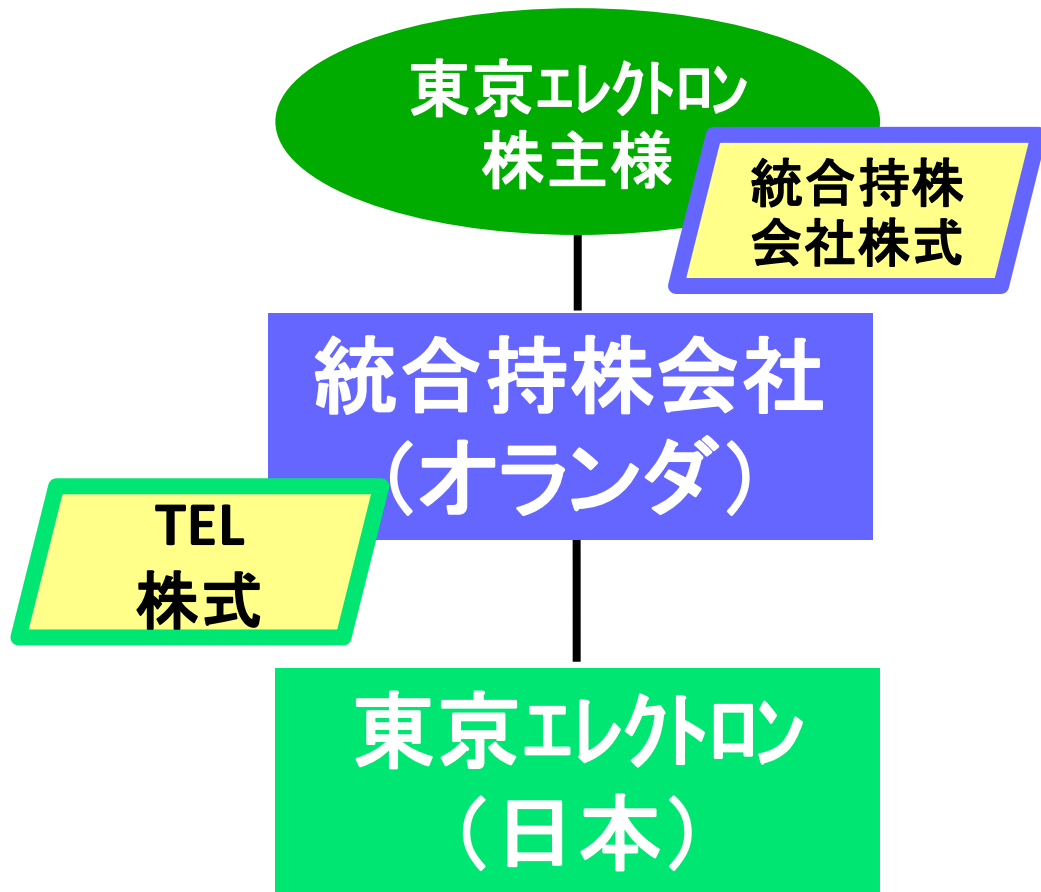
経営統合の方法



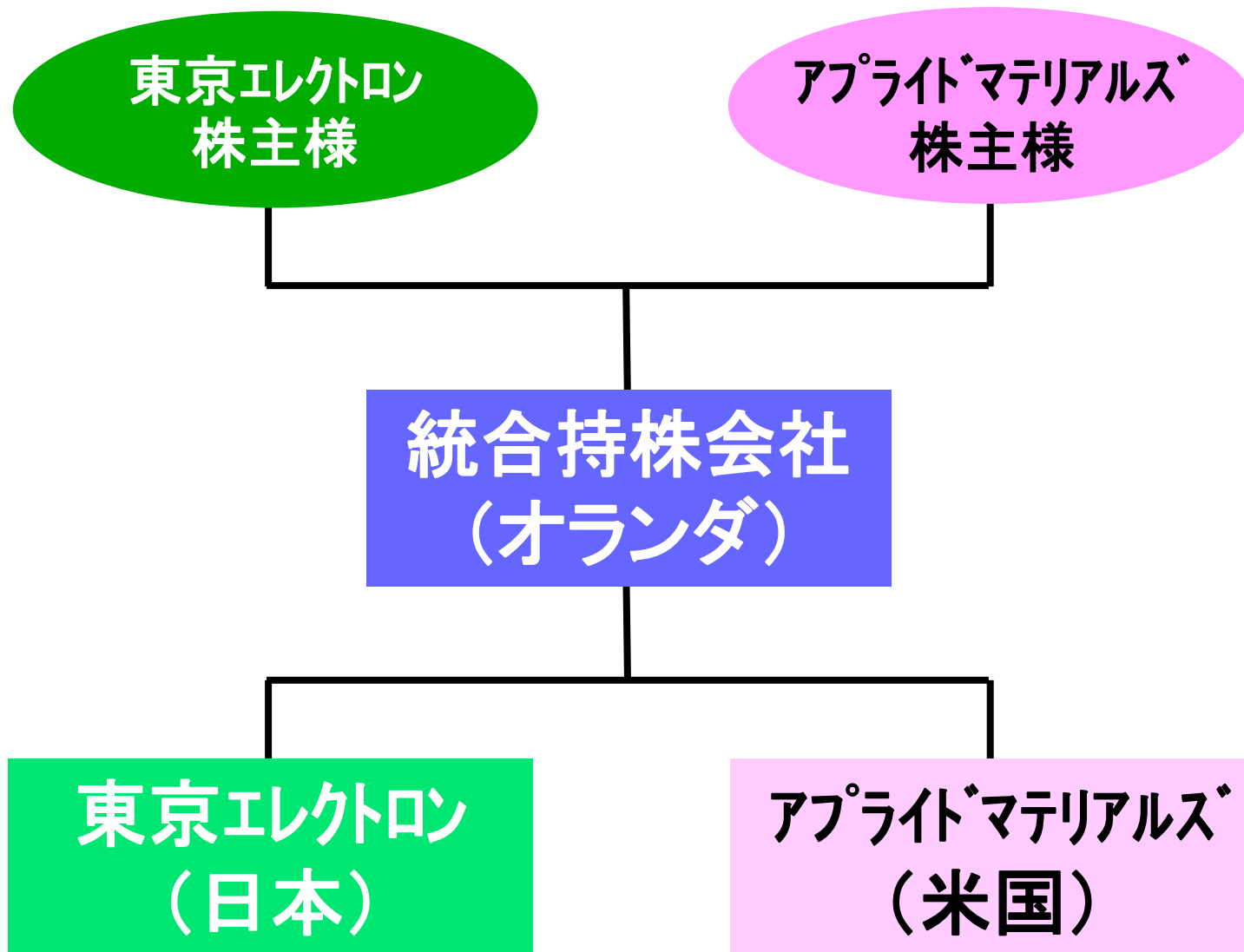
経営統合の方法



経営統合の方法



経営統合の方法



統合持株会社の株式について

- | | |
|-----------|---|
| 1. 上場株式市場 | 東京証券取引所、Nasdaq株式市場 |
| 取引通貨 | 日本円(東京証券取引所)
米ドル(Nasdaq株式市場) |
| 売買単位 | 1株(予定) |
| 2. 株主総会 | 開催地:オランダ
言語:英語(日本語併用) |
| 3. 配当金通貨 | 日本円 または 米ドル |
| 4. 開示書類 | 東京証券取引所から求められる書類
(決算短信、適時開示書類)、
有価証券報告書、四半期報告書、
株主総会参考書類 等
日本語での開示を継続予定 |

本経営統合の日程

本経営統合契約締結日	平成25年9月24日
米国証券取引委員会によるForm S-4の承認	平成26年5月13日
本株式交換契約承認取締役会 (東京エレクトロン)	平成26年5月14日
本株式交換契約承認株主総会 (東京エレクトロン)	平成26年6月20日
本経営統合契約承認臨時株主総会 (アプライド マテリアルズ)	平成26年6月23日
本株式交換、経営統合期日(効力発生日)	(暫定) 平成26年9月24日
本統合持株会社上場日(東証第1部(外国株))	(暫定) 平成26年9月24日

* 株式交換、経営統合効力発生には、本経営統合契約に定める各前提条件(例えば、両社の日本、米国その他の国における適用ある競争法に基づく関係当局の承認等がこれに該当します)が充足又は放棄される必要があるため、株式交換の効力発生のタイミングは、これらの前提条件の充足又は放棄の状況によって左右されることとなります。

44

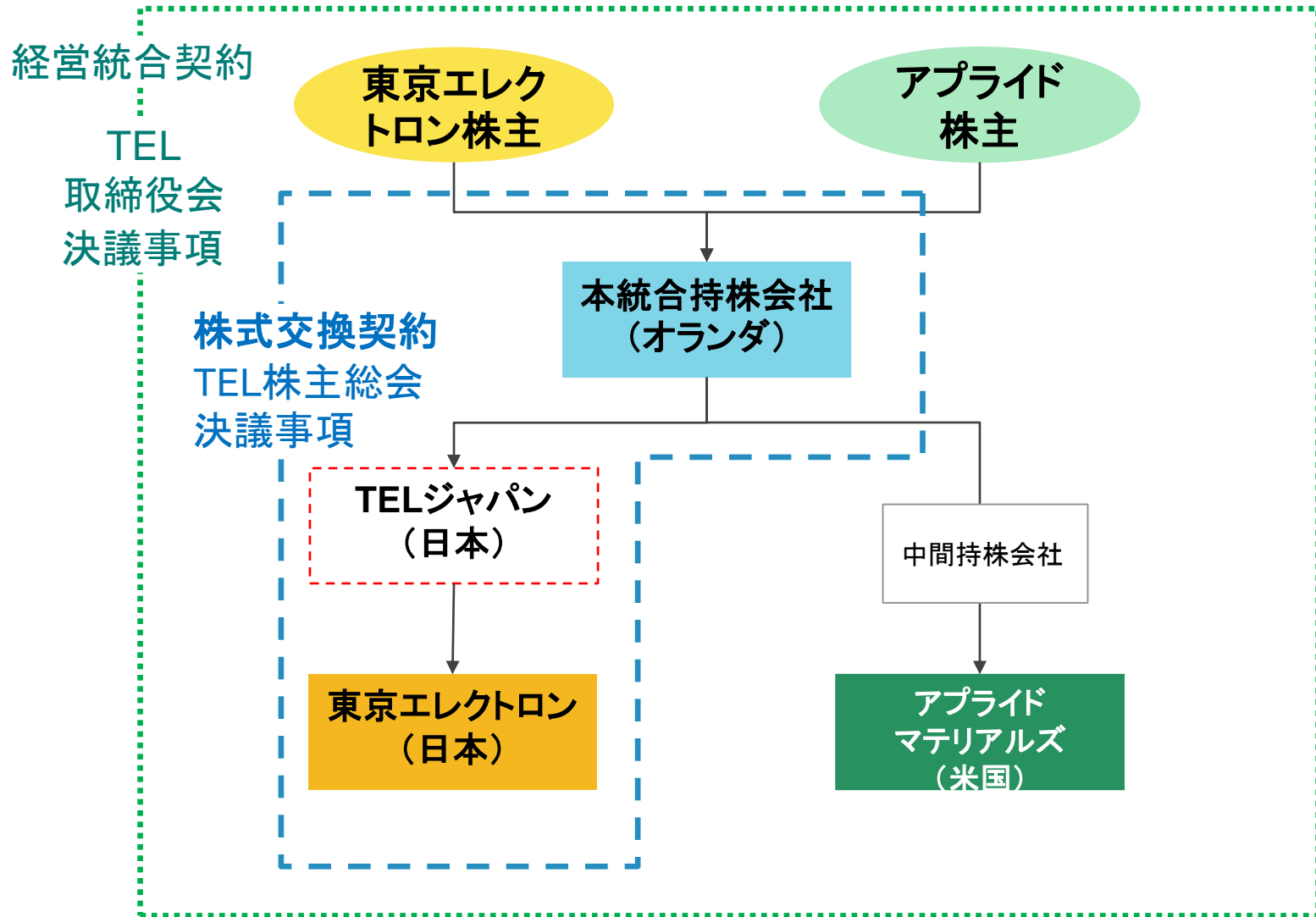
決議事項

1. アプライド マテリアルズとの経営統合に伴う当社とTELジャパン合同会社との株式交換契約承認の件
2. 取締役9名選任の件

第1号議案

アプライド マテリアルズとの経営統合
に伴う当社とTELジャパン合同会社
との株式交換契約承認の件

経営統合後の会社体制及び経営統合に伴い必要となる契約



株式交換契約の主な内容(招集ご通知8～9ページ)

第1条(本株式交換)

当社とTELジャパンの間で株式交換を行う

第2条(本株式交換に際して交付する株式及びその割当て)

- ・当社株主さまに対して、株式交換の対価として、
当社株式:統合持株会社株式=1:3.25 の株式交付を行う
- ・1株未満の端数相当分は、金額換算しTELジャパンが当社株主さま
に対して金銭で支払う

第3条(効力発生日)

平成26年9月24日(暫定)

株式交換比率の算定について

市場株価分析(平成25年6月24日～9月23日)

①時価総額の比較

	当社	アプライド・マテリアルズ
比率	1 (0.49～0.39)	2.02～2.58倍 (1)

②株式数の比較(財務アドバイザー意見書作成時、自己株式数を除く)

	当社	アプライド・マテリアルズ
株式数	179,685,381株	1,243,480,671株
比率	1	6.92倍

③株式交換比率

$$\frac{\text{当社の時価総額}}{\text{アプライド・マテリアルズの時価総額}} \times \frac{\text{アプライド・マテリアルズの株式数}}{\text{当社の株式数}} = 2.68 \sim 3.43$$

両社で最終合意した株式交換比率: 3.25

第2号議案

取締役9名選任の件

第2号議案 取締役9名選任の件

<取締役候補者氏名>

- | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 1. | <small>ひがし</small>
東 | <small>てつろう</small>
哲郎 | 6. | <small>はらだ</small>
原田 | <small>よしてる</small>
芳輝 |
| 2. | <small>つねいし</small>
常石 | <small>てつお</small>
哲男 | 7. | <small>ほり</small>
堀 | <small>てつろう</small>
哲朗 |
| 3. | <small>きたやま</small>
北山 | <small>ひろふみ</small>
博文 | 8. | <small>いのうえ</small>
井上 | <small>ひろし</small>
弘 |
| 4. | <small>いとう</small>
伊東 | <small>ひかる</small>
晃 | 9. | <small>さかね</small>
坂根 | <small>まさひろ</small>
正弘 |
| 5. | <small>わしの</small>
鷺野 | <small>けんじ</small>
憲治 | | | |

注) 井上弘氏及び坂根正弘氏については、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。



TM